

# Okamoto

セミコンジャパン2018出展のご案内

部品・材料ゾーン

Booth No. **2421** (HALL2)

に出展しています

## ハイブリッドマテリアルの総合砥粒加工提案

「技術の岡本」をスローガンに、総合砥粒加工機メーカーとして5つの提案を致します。

1

### ハイブリッドマテリアルに対して

WLCSP研削におけるCu+モールド樹脂加工また、TSV研削におけるCu+Si等の異種混合材同時平坦化技術により、IoT社会の実現へ貢献します

2

### 次世代パワーデバイス用材料

SiC・GaN等への低ダメージ、高速加工技術と装置

3

### bumpsウエーハの薄化

BGテープの高精度研削技術

4

### TSV

TTV自動補正を含めた新プロセス

5

### 電子部品

LT/LN等の電子部品の研削装置

